



2022年3月期 決算説明資料

東証スタンダード 証券コード：6614
2022年5月13日

2021年度（2022年3月期）は増益増収

- 車載向け半導体や5G向け産業機器や情報通信技術の用途で受注環境は順調に推移。
 - ・ 特に第3～第4四半期において、予想以上の増収。
 - ・ 利益面でも、高付加価値製品の取り組み、コスト削減の効果で計画以上の増益となる。
- 一方、世界的な半導体部材の調達難、調達期間の長期化、調達価格の高騰等に対する対応が必要な年度となった。

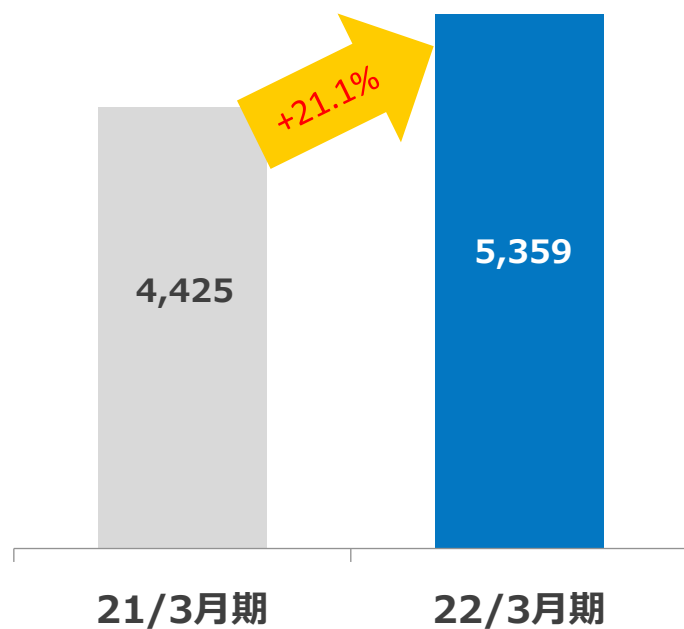
(単位：百万円)

	2022年3月期 修正業績予想 (21/8/11発表)	2022年3月期 修正業績予想 (22/2/10発表)	2022年3月期 修正業績予想 (22/5/11発表)	増減額 (2/10発表と5/11発表)	増減率 (2/10発表と5/11発表)
売上高	5,096	5,300	5,359	59	1.1%
営業利益	280	348	396	48	14.0%
経常利益	286	365	416	51	14.2%
当期純利益	200	244	327	83	34.2%

	2022年3月期 修正業績予想 (22/5/11発表)	2022年3月期 1～3Q実績累計 (4～12月)	2022年3月期 4Q実績 (1～3月)	2022年3月期 実績累計 (4～3月)
売上高	5,359	3,839	1,519	5,359
営業利益	396	266	129	396
経常利益	416	282	134	416
当期純利益	327	179	147	327

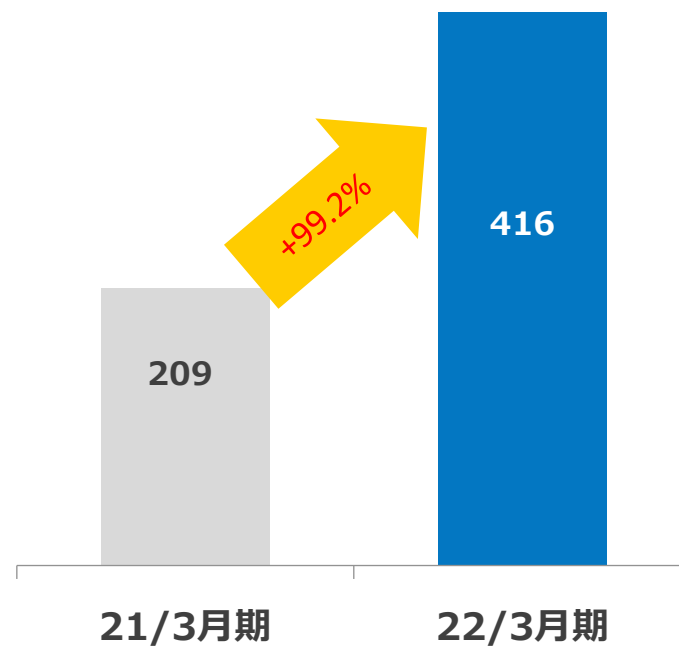
【売上高】

(単位：百万円)



【経常利益】

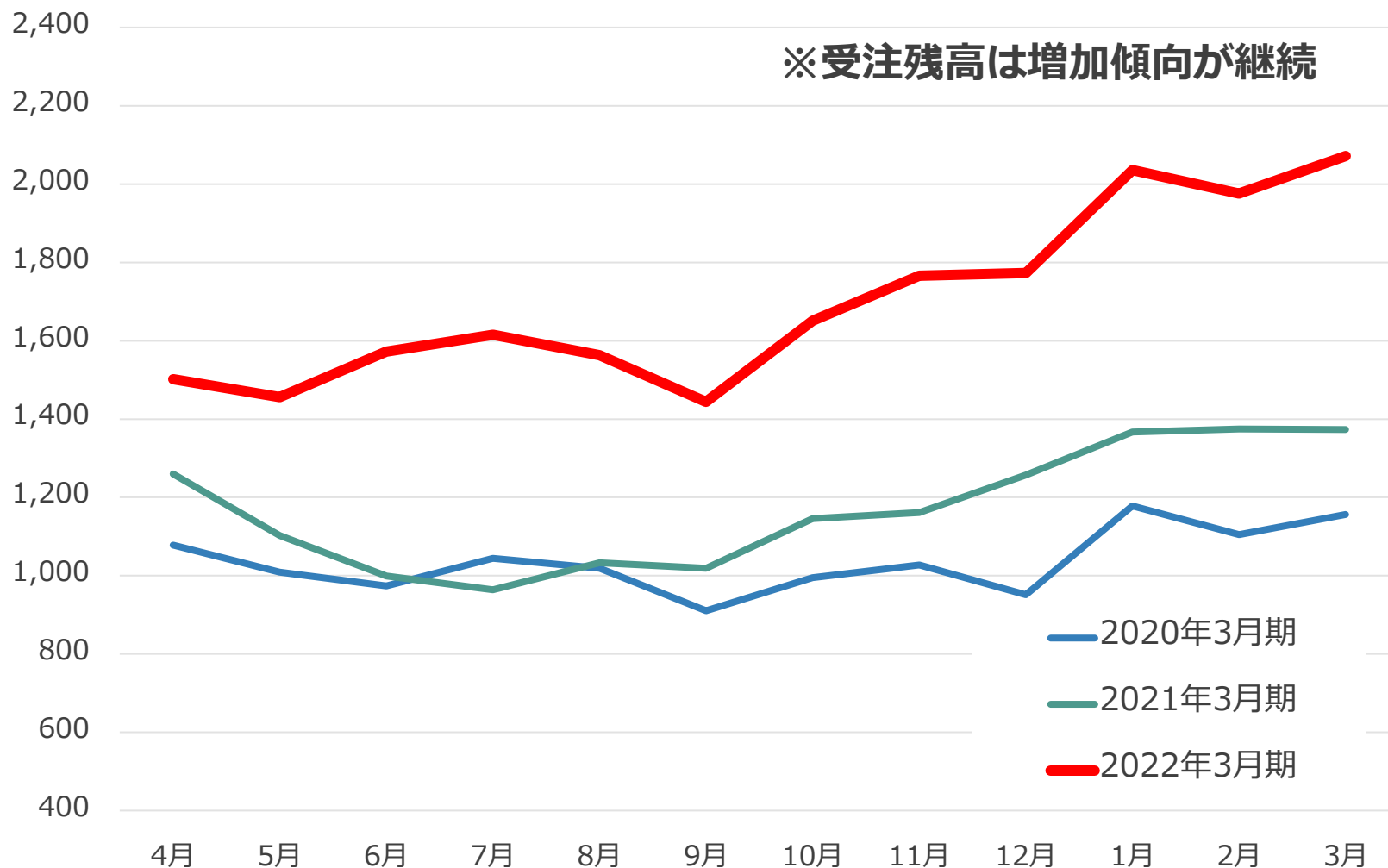
(単位：百万円)

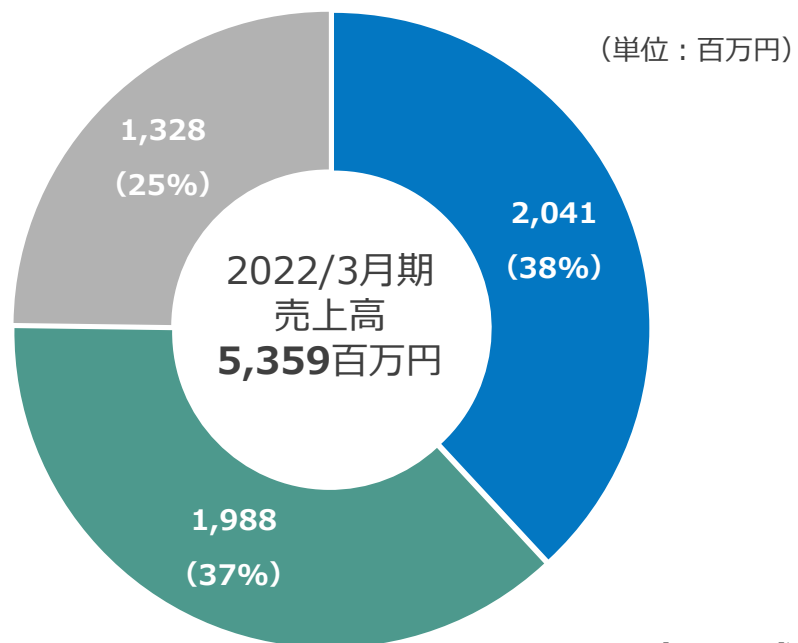


※売上高・経常利益とも前期比で増収増益。

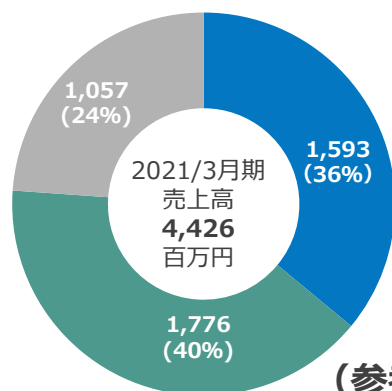
【受注残高（全社）】

(単位：百万円)





22/3月期売上構成



(参考) 21/3月期売上構成

電子システム事業

半導体検査・装置関連

バーンイン装置、バーンイン装置レンタル、バーンインボード、半導体部品の検査ボード、半導体のテストプログラム、高速通信機器、各種電子機器検査用ボード、専用計測器、電子機器の開発・設計・製造

マイクロエレクトロニクス事業

LSI設計（アナログ・デジタル）、IPコア

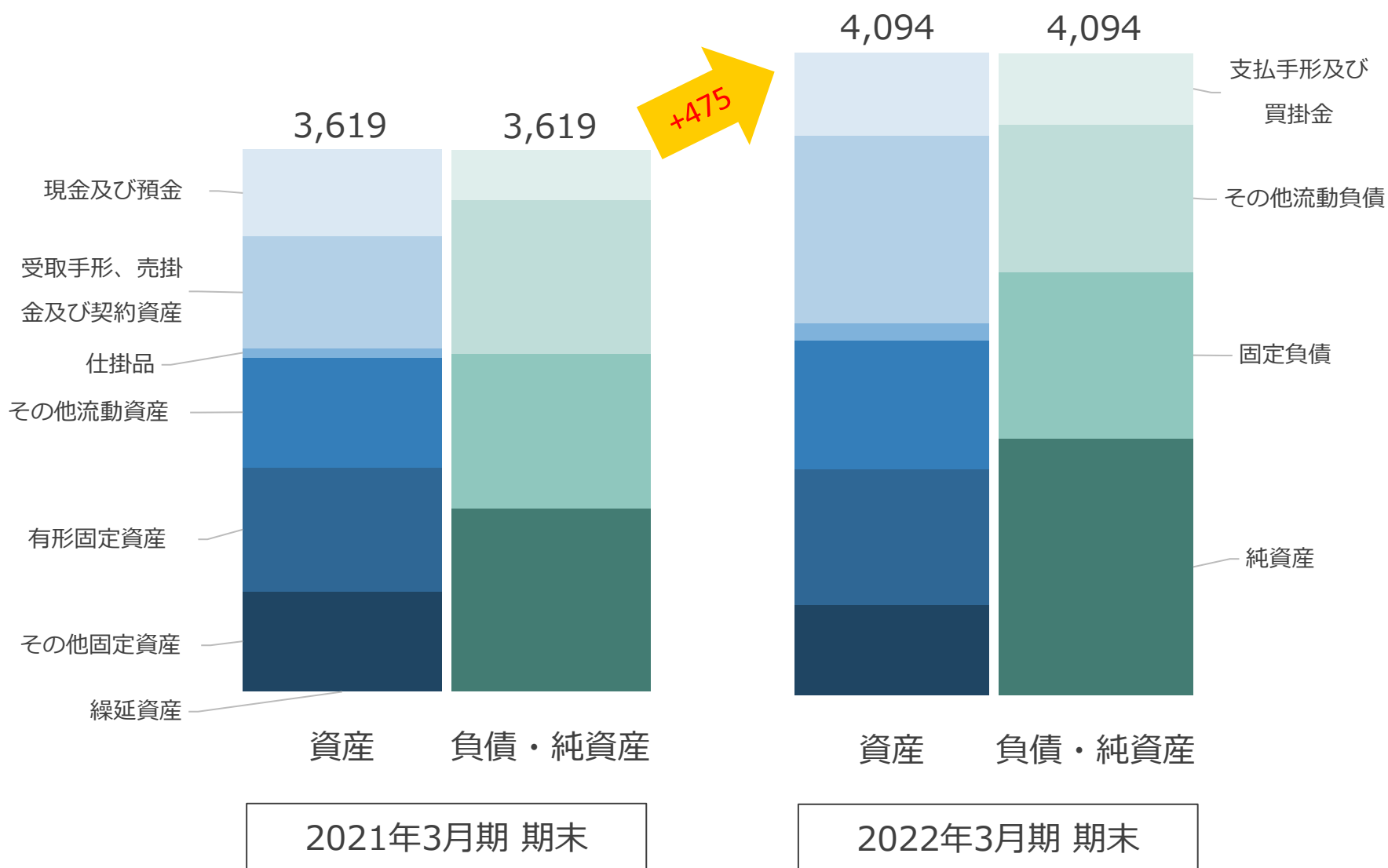
電源IC設計、高速I/F設計、イメージセンサ設計、画像処理系LSI設計、FPGA設計、ASIC設計、技術者派遣、JPEG、MIPI、ISP

製品開発事業

製品開発事業

画像関連機器、CMOSカメラモジュール、画像処理システム、画像処理モジュール

(単位：百万円)



2021年

4月21日 第三者割当増資

5月14日 決算発表

6月11日 決算説明会

6月28日 第49期 定時株主総会

7月 9日 東京証券取引所より「新市場区分における上場維持基準への適合状況に関する一次判定結果」の適合通知を受領

8月11日 第1四半期 決算発表
通期利益を上方修正

10月 4日 130万画素 MIPI 出力カメラモジュールの販売開始

10月18日 東京証券取引所の新市場区分「スタンダード市場」選択を開示

12月 3日 HD-PLC 第4世代規格 IEEE1901-2020 に準拠した電力線通信モジュールを試作

2022年

1月28日 小型月着陸実証機「SLIM」航法カメラ開発

2月 1日 九州事業所を拡張・機能強化

2月10日 第3四半期 決算発表
通期予想を上方修正

4月 1日 福岡デザインセンターを拡張

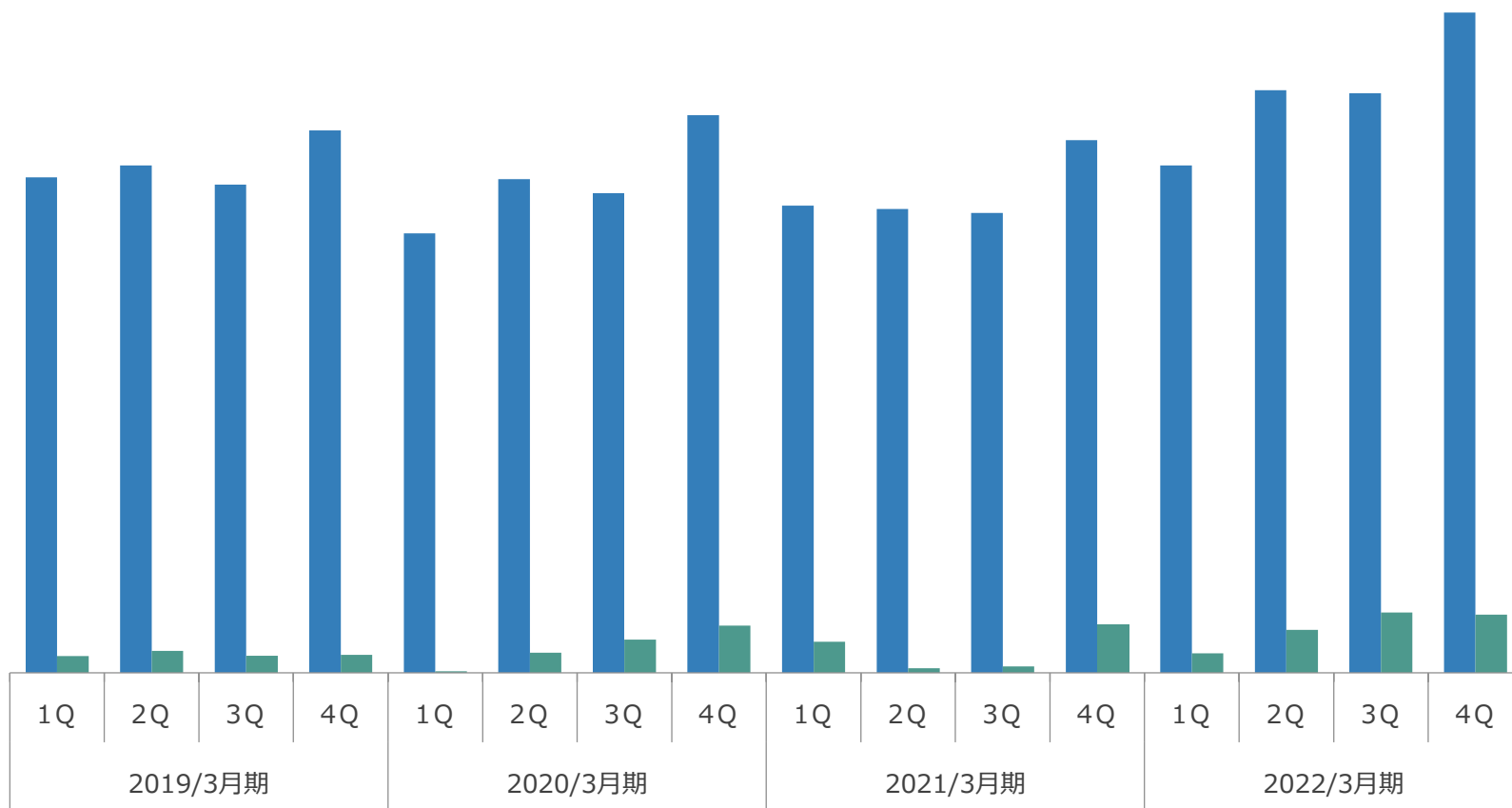
1Q

2Q

3Q

4Q

■ 売上高 ■ 経常利益



※経常利益の季節傾向を明確にするため、経常利益のスケールを調整しています。

半導体生産設備投資の回復により半導体後工程商材の需要増、車載製品用専用計測機器関連の受注増により、前年比売上増。新商材のIoT-PLC製品を市場投入後、引合い増加中。

【売上高】

(単位：百万円)



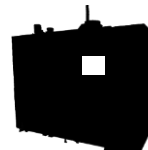
21年度 トピックス

➤ 車載製品向けを中心に主要商材の受注増



バーンインボード

前年比：174%



半導体検査装置販売・リース

前年比：189%



車載製品用専用計測機器関連

前年比：112%

スマートビルディング EXPO 2021 出展



2月 九州事業所拡張

1月 ネットコンJAPAN2022 出展

12月

7月 高速電力線通信推進協議会加入

P-TMFSU-H31

6月 陸通型式取得



HD-PLC

4月 HD-PLCアライアンス一般会員加入

新商材

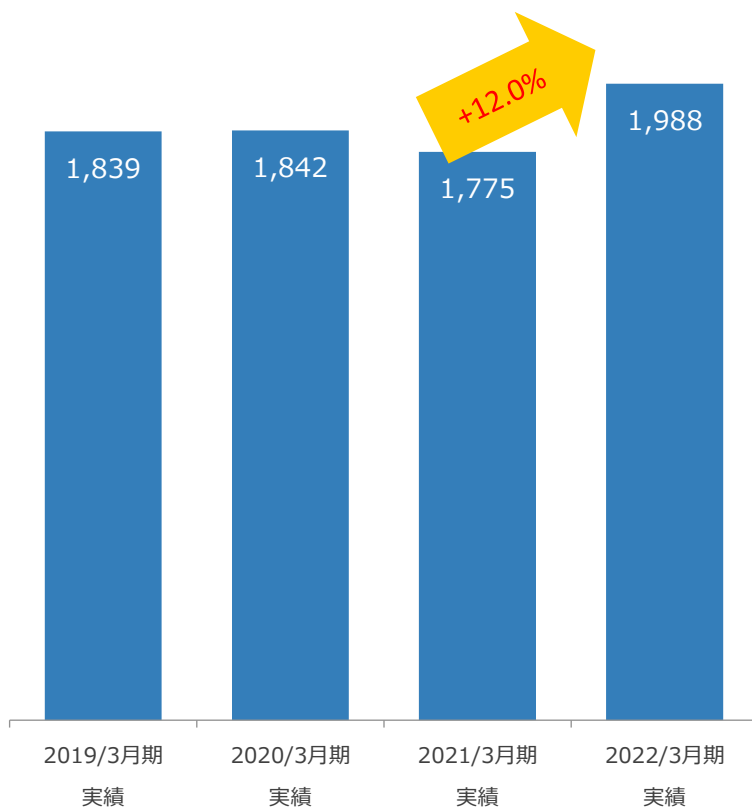
4月 IoT-PLC取り扱い開始・サンプル出荷



旺盛な半導体需要に支えられ、アナログはセンサー半導体、パワー半導体、デジタルは画像処理半導体の設計需要が堅調に推移、既存IP需要増加に加え、新たに画像処理IPも開発。

【売上高】

(単位：百万円)



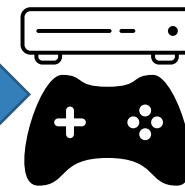
21年度トピックス

➤ アナログ半導体設計受託

スマートフォン向けセンサ関連
アナログ設計受託
前年比：120%



汎用商品向けパワー半導体関連
アナログ設計受託
新規受注

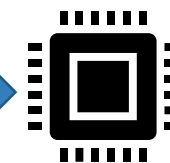


➤ デジタル半導体設計受託

DSC向け画像処理関連
デジタル設計受託
前年比：207%



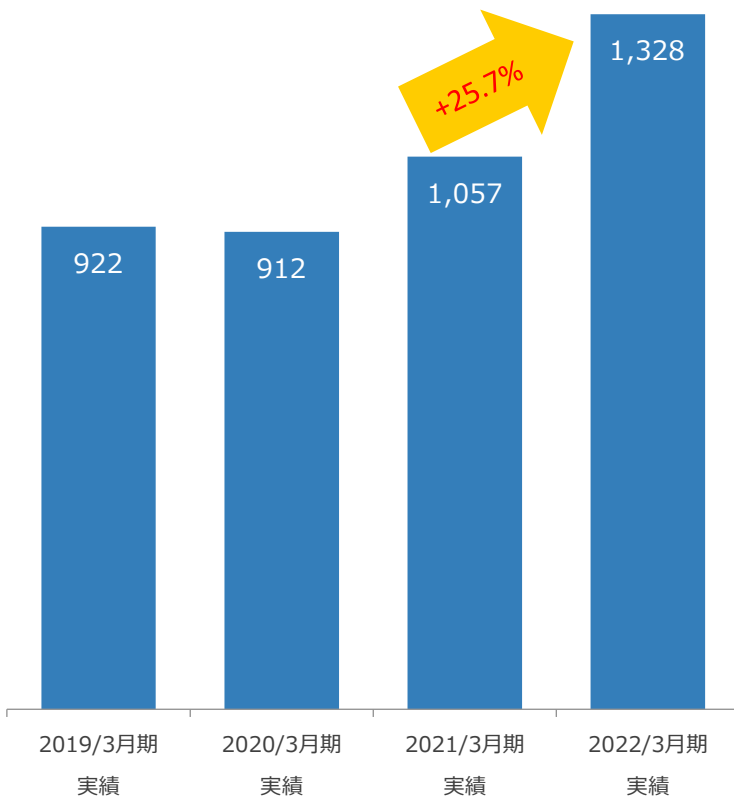
JPEG-IP 前年比：120%
画像信号処理IPも新規開発



車載・産業機器市況の回復基調継続に伴うカメラ需要増加、動画伝送機能搭載カスタムカメラ、マイナンバーカード応用機器等の出荷増加等により前年より販売が大幅に増加。

【売上高】

(単位：百万円)



21年度 トピックス

DX市場向け「画像センシング用カメラ」をエッジからクラウドまでラインナップ

エッジ画像処理	エッジAI用	クラウド画像処理用
<p>NEW SW開発キット インテリジェントカメラシリーズ (スマートカメラ)</p>	<p>NEW KBCR-S08MM AI用カメラ</p>	<p>NEW KBCR-S03TUA 顔認証用カメラ</p>
		<p>開発中 KBCR-ic21MG LAN出力カメラ</p>

ネプコンJAPAN2022出展 1月

国際画像機器展2021出展 12月



新製品

10月

エッジAI用 130万画素MIPIカメラリリース



KBCR-S08MM



9月 「チップワンストップ」で オンライン販売を開始



産学官共創プラットフォーム

8月 富山県ヘルスケア産業育成創出事業採択

新製品

4月

200万画素USBカメラ2機種リリース



KBCR-S03TUA, S03TU

半導体事業における増産に対応するため、人員増強を図っております。

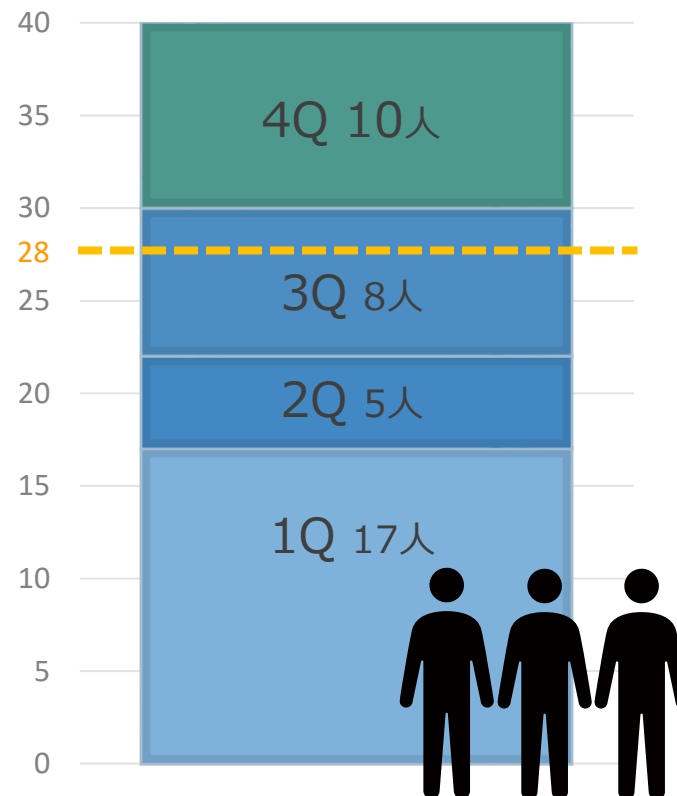
また、同期間中に退職者が発生したことに伴い、採用枠を増加。

通期で28人の採用計画に対し、40人の採用となりました。

人員

通期採用計画：28人

実績率
142.9%

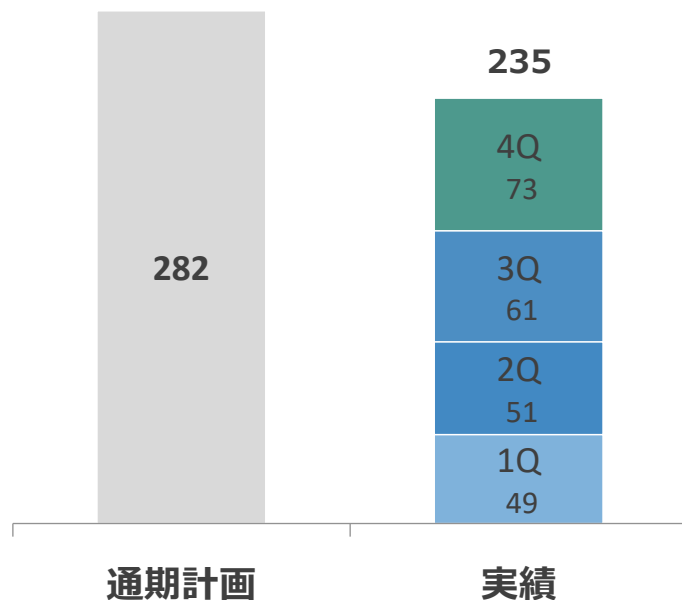


研究開発に投下している「工数」は順調に進捗しています。

研究開発費での進捗に対する差分は、主に開発単価の予実差異によるものとなります。

【研究開発費】

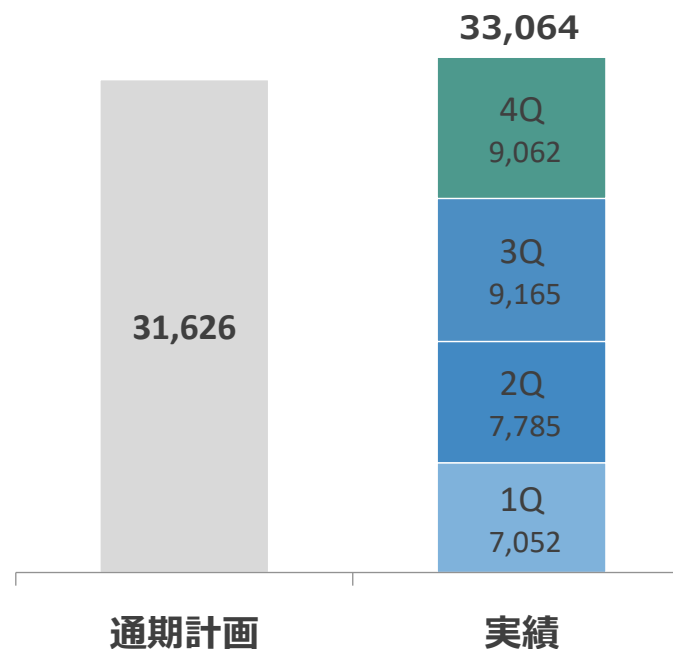
(単位：百万円)



実績率 83.7%

【研究開発工数】

(単位：H)



実績率 104.5%

顧客の未解決課題の解決、顧客ニーズの充足の視点で、競合他社に対して優位性のある技術・製品の開発に取り組みます。

研究開発分野

半導体検査装置、計測システム、
IPコア、高速IF回路、
画像処理システム、カメラの性能向上、
新機能開発

電子システム事業

- ・半導体検査装置・カスタム検査装置
IoT-PLC通信モジュール

マイクロエレクトロニクス事業

- ・JPEG IPコア・画像処理ISP IPコア

製品開発事業

- ・エッジAIカメラ・高画素インテリジェントカメラ・介護向けシステム

2022年度（2023年3月期）は増収増益

- 顧客ニーズを的確に捉え、生産性のより一層の向上と機動力を発揮して取り組みます。
- 顧客満足度の高い製品の開発、新技術の開発に積極的に先行投資するため、売上増加率7.6%に対し、経常利益増加率は4.0%となります。

全社

(単位：百万円)

	2022年3月期 実績	2023年3月期 予想	増減額	増減率
売上高	5,359	5,765	405	7.6%
営業利益	396	410	13	3.5%
経常利益	416	433	16	4.0%
当期純利益	327	337	10	3.2%
研究開発費	235	267	31	13.5%

セグメント別

(単位：百万円)

	2022年3月期 実績	2023年3月期 予想	増減額	増減率
売上高	5,359	5,765	405	7.6%
電子システム事業	2,041	2,318	276	13.5%
マイクロエレクトロニクス事業	1,988	2,051	62	3.1%
製品開発事業	1,328	1,396	67	5.1%

引き続き、配当による株主還元を実施する予定です。

(単位：円)

	1株当たり当期純利益および配当金	
	2022年3月期 実績	2023年3月期 予想
1株当たり当期純利益	75.35	76.54
中間配当金	0	0
期末配当金	10	10
年間配当金	10	10

※2022年5月13日現在において、配当予想額は、1株当たり = 10円を予定しております。

本資料で提供する情報のうち業績見通しおよび事業計画等に関するものは、当社が現時点で入手可能な情報と合理的であると判断する一定の前提に基づいており、リスクや不確実性を含んでおります。

従って、実際の業績は、様々な要因により、これらの見通しとは異なる結果になりうることをご承知おきください。

当社がこの資料を発行後、適用法令の要件に服する場合を除き、将来に関する記述を更新、又は修正して公表する義務を負うものではありません。

本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、又これを保証するものではありません。

本資料の著作権は当社に帰属し、目的を問わず、当社に事前の承諾なく複製又は転用することなどを禁じます。

【お問い合わせ先】

株式会社シキノハイテック

常務取締役管理本部長 広田 文男

e-mail : IR-contact@shikino.co.jp

TEL : 0765-22-3477 FAX : 0765-22-3916

ホームページ : <https://www.shikino.co.jp/>